

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2015年7月23日(23.07.2015)



(10) 国際公開番号

WO 2015/107990 A1

- (51) 国際特許分類:
C09J 179/08 (2006.01) C09J 11/06 (2006.01)
C09J 7/02 (2006.01) C09J 163/00 (2006.01)
C09J 11/04 (2006.01) H01L 21/60 (2006.01)
- (21) 国際出願番号: PCT/JP2015/050483
- (22) 国際出願日: 2015年1月9日(09.01.2015)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
特願 2014-004843 2014年1月15日(15.01.2014) JP
- (71) 出願人: 東レ株式会社(TORAY INDUSTRIES, INC.)
[JP/JP]; 〒1038666 東京都中央区日本橋室町2丁目1番1号 Tokyo (JP).
- (72) 発明者: 小田拓郎(ODA, Takuro); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 金森大典(KANAMORI, Daisuke); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP). 野中敏央(NONAKA, Toshihisa); 〒5208558 滋賀県大津市園山1丁目1番1号 東レ株式会社 滋賀事業場内 Shiga (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).
- 添付公開書類:
— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(54) Title: ADHESIVE COMPOSITION AND ADHESIVE FILM HAVING SAME, SUBSTRATE PROVIDED WITH ADHESIVE COMPOSITION, AND SEMICONDUCTOR DEVICE AND METHOD FOR MANUFACTURING SAME

(54) 発明の名称: 接着組成物ならびにそれを有する接着フィルム、接着組成物付き基板、半導体装置およびその製造方法

(57) Abstract: The present invention provides an adhesive composition having excellent strength in a cracked state, and is an adhesive composition characterized by containing a polyimide (A), a polyfunctional epoxy compound (B), an epoxy curing agent (C), and inorganic particles (D), the ratio of the polyimide (A) in a nonvolatile organic component being 3.0 wt% to 30 wt%, the ratio of the epoxy curing agent (C) in the nonvolatile organic component being 0.5 wt% to 10 wt%, and T/M being 400 to 8000, where T is the total number of grams of the nonvolatile organic component, and M is the number of moles of epoxy groups in the nonvolatile organic component.

(57) 要約: 本発明は、クラックが形成された状態での強度に優れた接着組成物を提供するものであり、(A) ポリイミド、(B) 多官能エポキシ化合物、(C) エポキシ硬化剤および(D) 無機粒子を含有し、不揮発性有機成分中における前記(A) ポリイミドの割合が3.0重量%以上30重量%以下、不揮発性有機成分中における前記(C) エポキシ硬化剤の割合が0.5重量%以上10重量%以下であり、かつ不揮発性有機成分の総グラム数をT、不揮発性有機成分中のエポキシ基のモル数をMとして、T/Mが400以上8000以下であることを特徴とする接着組成物である。

WO 2015/107990 A1